

後工程の役割を、図や映像で学ぶ

半導体 後工程 の基礎

講師
九州大学
大学院システム情報科学研究院
情報エレクトロニクス部門
准教授 木野 久志氏



2026年 1月26日(月) 13:00~17:00

お申し込み期間は 2025年10月30日(木)9:00から2026年1月21日(水)17:00までとなります。

受講料
初回特別提供 **3,300円(税込)**

定員：対面受講30名 / オンライン90名



●対面受講会場

福岡システムLSI総合開発センター
2F 講義室

住所 福岡市早良区百道浜3-8-33
TEL 092-822-1550



●お申込み方法

ふくおかISTe-learningのホームページより、「講座・セミナー等 申込」をクリックし、「半導体後工程の基礎」の「対面受講申込」または「オンライン(OL)受講申込」を選択ください。

ふくおかISTe-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスキリングセンター 事務局

- お申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です。 ■ お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。
- 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。 ■ 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。
- 会場にて全受講者に紙テキストを配布します。PDFテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)のダウンロードも可能です。 ※テキストの無断転載・複製等は禁止しています。
- 演習に使用するPC・MATLABライセンスは会場にて準備しております。



公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団

福岡半導体リスキリングセンター

半導体製品が完成するまでの「後工程」について、前工程との違いから検査・梱包・出荷までの流れをやさしく解説します。工程の役割を図や映像で学ぶことで各工程の意味やパッケージの多様性が理解できます。先端パッケージ動向にも触れる、後工程理解の入門講座です。半導体業界の新入社員・若手技術者は元より後工程を把握したい初学者におすすめする講座です。

第1章 はじめに

1. 半導体の後工程って？
2. 前工程・後工程(ダイソート工程から梱包まで)
3. 何で、後工程が必要ななの？
4. パッケージって何種類くらいあるの？
5. 用途に応じたパッケージの選び方

第2章 後工程全体の流れ

全体を俯瞰できる形での製造プロセスの流れ

※講座内容は一部変更になる場合がございます。

第3章 後工程プロセス全体（実際の工程のビデオ映像で現場感を掴みます）

撮影協力：株式会社 デンケン

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. ダイソート | 10. ダイマウント |
| 2. 表面テープの貼りつけ | 11. ベーキング処理 |
| 3. バックサイドグランド | 12. ワイヤーボンディング |
| 4. 保護テープ剥離 | 13. モールド |
| 5. 裏面チップング防止シート貼り | 14. ボール搭載 |
| 6. Dicing | 15. 後 Dicing |
| 7. チップピックアップ（良品だけ） | 16. ファイナルテスト（NG 品選別） |
| 8. フレームについての説明 | 17. レーザーマーク |
| 9. ペースト塗布 | 18. 検査・出荷準備・梱包 |

第4章 後工程パッケージの最新動向

1. なぜ後工程に注目が集まる？
2. 2.5/3D パッケージとは？
3. 微細再配線工程
4. Nvidia の目指すところ

定員5名
抽選制



クリーンルームに入室し、研究開発用設備の見学やサンプルの観察・測定を体験していただけます。

本講座の**受講者**を対象に、**無料**の**体験見学会**を開催します

2026年**2月20日**(金)13:30~16:30

会場：福岡超集積半導体ソリューションセンター

■応募詳細につきましては受講申込済の方に別途ご案内いたします。



福岡県内 中小企業の方は **受講料全額補助**

※消費税及び地方消費税を除く



詳細はこちら

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体
リスクリングセンターのホーム
ページから、申請要領・交付
要綱をご確認ください。

